裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

证券代码：688515　　证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2026_11_2

投资者关系活动类别	√公司现场接待　□电话接待 □其他场所接待　□公开说明会 □定期报告说明会　□重要公告说明会 √其他（上交所“我是股东”走进沪市上市公司活动）
参与单位名称	华电产融、杭州诺泽私募基金、明诚基金、上海国投研究院、杭州久阳智富私募基金、华安证券、上海翀云私募基金、杭州和达金融服务集团、华泰证券、东吴证券及个人投资者
日期时间	2026 年 11 月 17 日
地点	苏州市
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：黄婕；资本运营主管：张瑶等
投资者关系活动主要内容介绍	**说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。** **一、互动交流环节** **1、公司研发投入的绝对额和增速是怎么安排控制的？研发费用都由什么构成？** 答：公司 2026 年前三季度的研发投入为 2.28 亿元，与上年同期基本持平，研发投入占营业收入的比例为 40.34%，同比减少了 18.49 个百分点，公司在不降低研发投入的前提下持续降低研发费用率，进一步优化研发效率，为实现尽快扭亏奠定了基础。研发费用中主要为研发人员工资，剩余为芯片流片、测试等费用，公司将根据自身情况持续优化研发战略，坚持从投入型研发走向效率化研发。 **2、公司上游供应链晶圆、封测等涨价对公司的影响大不大，公司芯片的**

产能能否得到有效保障?

答：公司已和头部晶圆、封测厂商建立了长期稳定的合作，上游供应链价格本身受供需、订单周期、产能等多重因素扰动，存在一定的不确定性。公司将坚持推行多供应商策略，努力分散单一厂商风险，同时结合在手订单情况预判动态做备货与库存管理，设置安全库存，力争平抑上游价格波动带来的冲击，尽力保障客户产品的交付。

3、公司定增募投项目为什么打算研发 112G 的 IP？能不能用最通俗易懂的方式解释下 SerDes IP 具体指的是什么?

答：SerDes 就是串行器+解串器（Serializer/Deserializer），它不是某个具体产品，而是一类电路的通称。通俗的说，SerDes 就是芯片世界的快递分拣中心：把并排的一堆包裹压成一列高速列车送出去，到站再按顺序一件件拆回来，它的存在让数据在物理世界的损耗和噪声中，依然能准确、足够快地通过。公司定增募投项目之一面向数据中心场景的新一代高速互联网络通信方案研发项目的实施重点就是研发自主的高速互联底层 IP，该领域在 112G 以上的供给全球范围内基本由海外厂商主导，国产替代需求较高。公司从 IP 切入是因为 IP 位于产业链最上游，可复用到 Retimer、oDSP、交换、网卡及 CXL/UCIe 等产品方向。

4、公司的车载业务具体布局是什么?

答：公司在车载芯片领域正布局 PHY+Switch+SerDes 的全栈车载解决方案。车载 PHY 芯片方面，百兆和千兆速率芯片已量产，为公司成熟产品，随着导入客户不断增加，出货收入和规模将持续放量；车载百兆物理层芯片（YT8010 系列）及千兆以太网物理层芯片（YT8011 系列）已实现规模化量产，广泛搭载于主流新能源车型，车载千兆以太网物理层芯片在智能座舱升级需求驱动下出货量显著提升，成为业务增长核心引擎。车载 TSN Switch 芯片方面，公司于 2025 年度发布的国产首款商用的车载 TSN Switch 芯片 YT9908/YT9911 系列，填补了国内自主可控在该领域的空白，该芯片通过多端口（8/11 端口）设计，可连接智能驾驶、智能座舱、雷达、域

控制器、娱乐系统等设备，实现数据高效交互，应用在包括 ADAS 高阶辅助驾驶系统、车载座舱系统、车载网关、车载域控等场景，2026 年前三季度车载 TSN Switch 芯片实现的营收增速尤为突出。车载 SerDes 芯片方面，公司 YT78/79 系列包括加串芯片 3 款、解串芯片 6 款，支持 2G 至 6.4G 多种速率，全面覆盖 200 万到 1,200 万像素车载摄像头应用，已实现与国际主流产品 Pin-to-Pin 兼容，AEC-Q100 认证正在进行中，并正在给多家国内头部整车厂及一级供应商送样测试中。

5、公司网通业务需求的驱动逻辑是什么？

答：网通业务的需求由“端口数量增加”和“单端口速率升级”两条主线驱动，再叠加国产替代的结构性机会。一是接入网代际升级，从千兆走向超千兆、万兆：“十五五”规划明确推进万兆光网规模部署，2026 年 4 月工信部公布的万兆光网试点中，136 个项目通过验收，覆盖小区、工厂、园区三类场景，同时 FTTR 也进入规模建设阶段。接入速率每提升一个台阶，网关、ONU 和路由器侧配套的电口 PHY 都要同步升级，2.5G、5G、10G 端口需求随之释放。二是 Wi-Fi7 渗透，使 2.5G 有线口逐步成为标配。Wi-Fi7 的无线速率已明显超过千兆，如果整机仍配千兆电口，有线侧就会成为瓶颈，因此 Wi-Fi7 的 AP 和路由器普遍采用 2.5G 上行。这是当前 2.5GPHY 需求最直接的来源，也是公司 2025 年 2.5G 产品收入同比增长 34.61%的市场基础。三是因为境内市场主要供应商仍为瑞昱、博通、美满电子等海外厂商，国产替代仍处早期，机会明显。

6、公司的主要研发方向是什么？网通领域 10G 以太网物理层芯片研发进展如何？

答：公司坚持“技术立企”战略，持续加大研发投入强度，研发方向聚焦以太网物理层芯片等关键领域开展核心技术攻关，通过系统性知识产权布局强化技术壁垒。公司 10G 以太网物理层芯片 MPW 流片已完成，预计 2026 年完成 FullMask 流片，2027 年实现产品量产。新产品的具体情况请持续关注公司后续公开披露的公告及定期报告。

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单(如有)	无